

\~15~

DERWENT-ACC-NO: 1983-792782

DERWENT-WEEK: 198342

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Soldering semiconductor element to parent metal - using solder portion

or granules coated with insulation oil (J5 25.8.80)

PATENT-ASSIGNEE: NEW NIPPON ELECTRIC CO LTD[NIDF]

PRIORITY-DATA: 1979JP-0016902 (February 15, 1979)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	
PAGES	MAIN-IPC		
JP 83043183 B	September 26, 1983	N/A	004
N/A			
JP 55110050 A	August 25, 1980	N/A	000
N/A			

INT-CL(IPC): B23K001/00; B23K035/00 ; H01L021/58

ABSTRACTED-PUB-NO: JP83043183B

BASIC-ABSTRACT: Method is claimed for soldering a semiconductor pellet to a

parent metal such as stem substrate doubling a heat radiator in such manner. A

solder piece or granular solder coated with an insulation oil of 10 to 100000

cst in dynamic viscosity and inert to the parent metal is put on the parent

metal and then the pellet is put on the solder and heated.

(J55110050-A)

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/9

DERWENT-CLASS: L03 M23 P55

CPI-CODES: L03-D03F; M23-A;

BEST AVAILABLE COPY

整理番号 4750002.9

発送番号 147858

発送日 平成11年 7月12日 1 / 2

## 拒絶理由通知書

特許出願の番号	平成 9 年 特許願 第 3 2 6 1 5 4 号
起案日	平成 1 1 年 7 月 7 日
特許庁審査官	坂本 薫昭 9 2 6 5 4 R 0 0
特許出願人代理人	山下 稔平 殿
適用条文	第 2 9 条第 2 項

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から 6 0 日以内に意見書を提出されたい。

### 理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記 of 刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 2 9 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

- ・請求項 1 ~ 1 1
- ・引用文献等 1
- ・備考

半田付けを不活性中の液体中において行う実装方法は引用例 1 に開示されている。そして、半田付け方法において、超音波振動を使用することは普通に行われている技術である。

続葉有

発送番号 147858

発送日 平成11年 7月12日 2 / 2

続 葉

引 用 文 献 等 一 覧

1. 特開平3-60134号公報

先行技術文献調査結果の記録

・調査した技術分野 IPC第6版  
H01L 23/12

この先行技術文献調査の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知書の内容に関する問い合わせ先  
審査第四部電子素材加工 審査官 坂本薫昭  
電話 03-3581-1101 内線 6362